505536002 06/20/2019

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT5582799

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
TSUTOMU MURATA	06/20/2019

RECEIVING PARTY DATA

Name:	SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC	
Street Address:	5005 E. MCDOWELL ROAD	
Internal Address:	MAILDROP A700	
City:	PHOENIX	
State/Country:	ARIZONA	
Postal Code:	85008	

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	16447311

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (602)244-3169

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent

using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 6022443574

Email: patents@onsemi.com

Correspondent Name: SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC

Address Line 1: 5005 E. MCDOWELL ROAD

Address Line 2: MAILDROP A700

Address Line 4: PHOENIX, ARIZONA 85008

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	ONS03424C01US
NAME OF SUBMITTER:	SHARRON CASTILLO
SIGNATURE:	/Sharron Castillo/
DATE SIGNED:	06/20/2019

Total Attachments: 3

source=ONS03424C01US_20190620_Assignment#page1.tif source=ONS03424C01US_20190620_Assignment#page2.tif source=ONS03424C01US_20190620_Assignment#page3.tif

PATENT 505536002 REEL: 049540 FRAME: 0093

ASSIGNMENT & AGREEMENT ONS03424US

総定及び契約額 ONS03424US

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I,

Name of (City and State OR Country)

Tsutomu Murata

Mizuho-shi Japan

agree to sell, assign, and transfer, and do hereby sell, assign, and transfer to Semiconductor Components Industries, i.l.C., a limited liability company of the State of Delaware, having its principal office in Phoenix, State of Arizona, United States of America, and its successors, assigns, and legal representatives ("SCI"), the entire right, title, and interest in and to the inventions and discoveries as described, illustrated, and/or claimed in

Title: METHODS AND APPARATUS FOR AN AMPLIFIER INTEGRATED CIRCUIT

Attorney Docket No.: ONS03424US

Serial No.: US 16/447149

Filing Date: June 20, 2019

together with the entire right, title, and interest in and to the above listed application(s), and in and to any and all provisional, non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, international, foreign, and any and all other applications related thereto, and also including any and all grants, issuances, letters patent, reissues, reexaminations, renewals, priority rights, and priority claims related to any of the foregoing, and any and all rights to collect past damages for infringement of any of the foregoing (the "Patent Rights").

I further authorize SCI to apply for and hold and maintain the Patent Rights throughout the world directly in its own name or any other name which SCI deems appropriate in its sole discretion, and to claim the priority of the filing date of the above listed application(s).

適正・相当な対価を受領しており、それが十 分な対価であることを認めた上で、私こと

(市及び州又は国)

の (氏名)

Tsutomu Murata

Mizuho-shi Japan

は、以下に説明、図解、及び/又は、請求された発明及び発見に対する全ての権利、所有権及び利益を売却、譲渡することに同意し、デラウェア州の有限会社であり本社をアメリカ合衆国アリゾナ州フェネックスに置くSemiconductor Components industries, LLC、その承継人、譲受人及び法定代理人(以下「SCI」)に売却及び譲渡を行うものである。

所有機: METHODS AND APPARATUS FOR AN AMPUFIER INTEGRATED CIRCUIT

代理人明細書番号: ONS03424US

シリアル番号: US 16/447149

申勝臼: <u>June 20, 2019</u>

これには、上記にリストされた申請、及び全 ての仮の、非仮の、分割の、総続の、一部継 続の、国際の、外国の申請、及びそれに関連 するその他の申請に対する全ての権利、所有 権、利益に加え、前述のいずれの許諾、発 行、特許証、再発行、再審査、更新、優先 権、優先権の主張及び前述のいずれの侵害の ため過去の損害賠償を得る権利全て(以下 「特許権」)を含んでいる。

私は、SCIに、自己の名で又は SCIが単独の裁 業で適切とみなすその他の名称で、直接世界 に特許権を申請し、保有し、維持すること、 及び、上配にリストされた申請に関する申請 日の優先権を主張する権利を許諾する。

1/3/2-52

I agree that, when requested, I will, without charge to SCI, sign all papers, take all rightful oaths, and do all acts which may be necessary, desirable, or convenient for securing, maintaining, and enforcing the Patent Rights in any and all countries and for vesting title thereto in SCI or its nominees.

I represent and warrant that I have full right to convey the entire right, title and interest herein sold, assigned, and transferred, and that the Patent Rights hereby conveyed are free from all prior assignment, grant, mortgage, license, or other encumbrance to anyone other than SCI. I covenant and further warrant that I will not convey hereafter any part of the Patent Rights to anyone other than SCI or do any act whatsoever conflicting with this ASSIGNMENT & AGREEMENT.

I hereby authorize SCI or anyone it may properly designate to insert in this ASSIGNMENT & AGREEMENT the filing date and serial number of the above listed application(s) when ascertained. More than one counterpart of this ASSIGNMENT & AGREEMENT may be executed, each of which will be deemed an original.

私は、要求された場合、私が、SCIに請求することなく、全ての文書に署名をし、全ての正当な宣誓をし、SCI又はその使命者が所有権を受けるため、及び全ての国々での特許権を、確保、維持、実行するため必要である、望ましい、又は便宜的であろう全ての行為を行うことに同意する。

私は、私が、ここにおいて売却され。譲渡される全ての権利、所有権、利益を行う完全な 権利を保有し、ここにおいて譲渡される特許 権は、SCI以外のいずれの者に対して、事前の 契約、許諾、抵当権、ライセンス又はその他 いかなる負担が無いことを表明し、保証す る。私は、私が、今後、SCI以外のいずれの者 に対しても特許権の一部を譲渡しないこと、 又は、本譲渡及び契約書に抵触するものは如何なること行なわないことを誓約し、保証す る。

私は、確認できる場合、上記にリストされた 申請の申請日及びシリアル番号を本譲渡及び 契約書に記入することを、SCI 又は適切に指定 することができる何れかの者に対し、許可す るものとする。本譲渡及び契約書の副本 1 通 以上で締結することができ、それぞれは、原 本とみなされるものとする。

2/3 ~~ >>

Doc#: 350863v1

ASSIGNMENT	&	AGREEMENT
ONS03424US		

By (Inventor signature): 署名权 (発明者の署名):	Qeitoni	Murata			
Tsutomu Murata					
Witnessed by (Witness signa 立会人書名欄(立会人の署	nture): 名): <u>日〇介</u>	was to grant			
Printed name of Witness: 立会人の活字体氏名: Hironori Terazawa					
Signed and Witnessed on (d: 署名及び認証日:	ate): June -	20,2019			

3/3~~~3

PATENT REEL: 049540 FRAME: 0096